



【千葉】ハードウェア開発（モジュール製品）～在宅勤務・フレックス制度有～

TDK株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ設計・装置...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

TDK株式会社

Job ID

1472768

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Chiba Prefecture

Salary

6 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】初年度 21日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季休暇 年末年始

Refreshed

May 9th, 2024 20:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2215297】

～東証プライム上場の電子部品メーカー/世界初『フェライトコア』を製品化し現在、「自動車」「ICT」「産業機器・エネルギー」の3つの成長市場で拡大・海外売上高比率91.9%のグローバルカンパニー～

■部門ミッション

社内で新規の事業開発を担っており、特に当課ではセンサ技術を応用したIoTモジュールによるソリューション開発をミッションに業務を遂行しています。

■業務内容:

当ポジションではセンサをはじめとする当社の多様なデバイスを組み合わせ、IoT社会に貢献するモジュール製品の開発に

より新製品・サービスの事業化に携わっていただきます。

- ・センサモジュールの構造設計
- ・センサモジュールの特性評価と信頼性評価
- ・IoT機器筐体の基本設計、詳細設計

Required Skills

■必須条件： ・センサモジュール製品における筐体機構設計の経験をお持ちの方（3D CAD（Solidworks）による機構設計もしくは構造設計、金型部品やプレス部品等の2D機械製図、センサやMCUを搭載したモジュール基板設計、製品の信頼性評価および検証に関わる業務経験 etc.） ■歓迎条件： ・CAE/FEM解析の実務経験 ・デジタル/アナログ混載回路設計経験 ・回路設計、パターンレイアウトの実務経験 ・オシロスコープやロジックアナライザー等の計測器を用いた解析経験 ■求める人物像： ・筐体機構設計、構造設計のスキルをお持ちで、要求具体化から試作評価・量産立ち上げまでの実務経験をお持ちの方

Company Description

■受動部品・セラミックコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品、回路保護部品、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ■センサ応用製品・温度センサ、圧力センサ、磁気センサ、MEMSセンサ■磁気応用製品・マグネット、高性能磁気ヘッド、HDDヘッド用サスペンション■エナジー応用製品・エナジーデバイス、電源（産業機器用、xEV向け車載用など）■その他・フラッシュメモリ応用デバイス、電波暗室、FA機器